

ディスペンサー用ソルダペースト

PF305-5091VO

超微小吐出対応

- ディスペンサーで塗布径100μmを実現
- 良好な微小溶解性

Solder Paste for dispensing

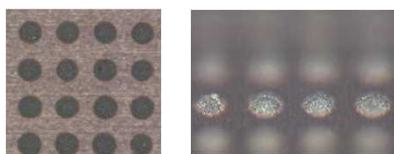
PF305-5091VO

● 一般特性

項目	代表特性	試験方法
合金組成	Sn-3.0Ag-0.5Cu	-
粒度	2~12μm	-
フラックス含有量	16.0wt%	JIS Z 3197
ハライド含有量	0.04%	JIS Z 3197
フラックスタイプ	ROL1	IPC J-STD-004
粘度	100Pa・s	JIS Z 3284

上記特性値は代表値であり、保証値ではありません。本製品は、合金組成、粒度ならびにフラックス含有量のカスタマイズが可能です。詳細は営業スタッフまでお問い合わせ下さい。

安定した連続吐出性

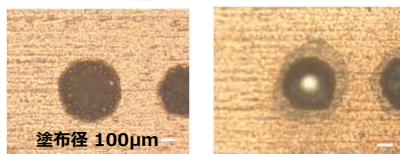


- 【吐出条件】
- ・吐出装置：R-jet（エンジニアリングシステム株式会社製）
 - ・使用ノズル：φ=70μmセラミックノズル
 - ・塗布径：100μm
 - ・吐出間隔：100μm

試験協力：エンジニアリングシステム株式会社

良好な微小溶解性

リフロー前 リフロー後



- 【リフロー条件】
- ・予備加熱：150~190℃ 90秒
 - ・ピーク温度：245℃、220℃以上：40秒
 - ・O₂濃度：1000ppm（3000ppmでもリフロー可）